

### 【Causes/processes involved/keys to judgment】

An adhesive material attached on CCL copper foil prior to copper plating acts as an etching resist to cause the defect. (Before copper plating – etching process)

## 1-8-1-2 テープ糊短絡／胶带胶迹的短路 / Short by tape adhesive

【特徴】 付着糊の下に残った銅箔による複雑形状の短絡

【特征】 在铜箔下面残留胶迹成为复杂形状的短路。

【Characteristics】 An irregular-shaped short by copper foil of CCL left under attached adhesive

【原因・判断ポイント・発生工程】 積層板銅箔の表面に付着した粘着テープ糊が E T レジストとなった為に、めっき銅だけは E T されたが、積層板銅箔は E T されずに出来たもの（銅めっき前～ E T 工程）

【原因、判断要点、发生工序】 因为铜箔表面附着的胶带胶成为 ET 剂，所以，只有镀铜层被 ET，而层压板铜箔不被 ET 所引起的（镀铜前～ ET 工序）。

### 【Causes/processes involved/keys to judgment】

Tape adhesive adhered to the copper foil of a CCL acts as an etching resist. Plated copper is etched but the copper foil of CCL is left unetched to cause the defect. (Surface preparation prior to copper plating - etching process)



【コメント】  
顕微鏡倍率 ×

【注釋】  
显微镜倍率 ×

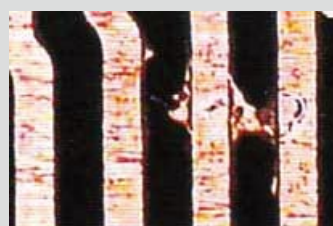
【Comments】  
Magnification: ×



【コメント】  
顕微鏡倍率 ×

【注釋】  
显微镜倍率 ×

【Comments】  
Magnification: ×



【コメント】  
顕微鏡倍率 ×

【注釋】  
显微镜倍率 ×

【Comments】  
Magnification: ×



【コメント】  
顕微鏡倍率 ×

【注釋】  
显微镜倍率 ×

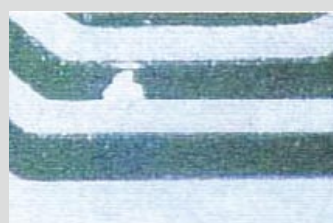
【Comments】  
Magnification: ×

## 1-8-1-3 CF 接着剤短絡／CF 粘性物的短路 / Short by carrier film adhesive

【特徴】 U T C の C F 接着物の下に残った U T C 銅箔短絡

【特征】 在 CF 粘性物下面残留 UTC 的短路。

【Characteristics】 Short by UTC foil left under carrier film adhesive for UTC.



【コメント】  
顕微鏡倍率 × 175

【注釋】  
显微镜倍率 × 175

【Comments】  
Magnification: ×175